

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-009

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>                              |
| 参与单位名称/人员姓名   | 东方财富、新财富、国泰海通、证金投资、壹润投资、涵崧基金、恒泰永成基金、亚太汇金基金、瑞联私募基金、中大情私募基金、民沣资本、尚颀资本、松禾资本、盈然资本、林亿资本、鼎爵资本、财沣投资、前海坚石资管、前海阶石资本、瑞业资管、翰烜资管、金港湾私募基金、嘉亿资管、云众创融投资、北大纵横管理咨询集团有限公司及个人投资者                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2025 年 11 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 地点            | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事：宋嘉斌<br>董事会秘书、财务总监：蒋伟红<br>证券事务代表：陈远紫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p><b>Q1、公司布局的几大业务板块的发展历程及其相互之间的联系？</b></p> <p>公司长期坚持以客户需求为导向，以核心技术创新为驱动，目前主要有智能卡、半导体、数字与能源热管理三大业务板块，其中智能卡业务作为公司传统优势领域，凭借深厚的技术积累和广泛的市场覆盖，持续保持稳定发展，为公司奠定了坚实的基础。</p> <p>为进一步延伸产业链，2019 年宁波澄天专用芯片项目竣工并投产，产品一部分自用，一部分对外销售，依托在专用芯片封装领域积累的工艺与制造基础，公司积极把握国产替代的战略机遇，逐步拓展至功率半导体封装材料领域，该业务于 2023 年实现规模化量产，现已成</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>为公司重要的增长点之一。</p> <p>伴随着公司在高导热、高可靠性封装材料体系上持续深化，能力边界不断拓展。基于在高导热金属材料、蚀刻、电镀与钎焊等核心工艺的深厚积淀，公司精准把握AIDC建设带来的液冷散热需求，顺势切入该赛道，实现了从“封装材料”到“散热结构件”，再到“系统级液冷解决方案”的自然产业延伸，形成了跨板块的技术协同与价值增益，共同构成了公司多元化协同发展的业务格局。</p> <p><b>Q2、公司新拓展的液冷业务领域与其他液冷赛道厂商相比，有何不同之处，其竞争优势及技术壁垒是什么？</b></p> <p>（1）公司的液冷业务并非从传统机柜或冷板加工切入，而是基于公司在半导体封装材料领域长期积累的材料、工艺与设计能力，形成了从半导体封装材料到机柜液冷关键部件，再到系统级二次侧液冷解决方案的自然延伸，实现具备设计生产封装材料、液冷零部件和提供二次侧整体解决方案的完整能力链条。</p> <p>（2）公司以半导体封装材料为底层技术源点，形成了产品、商业模式与制造体系三位一体的差异化竞争优势，具备从底层工艺到系统集成成的全链路能力：</p> <p>在产品体系上，公司自封装材料能力延展出下一代MLCP、冷板、波纹管、分水器、UQD快接头、液冷机柜，并向CDU 模块进一步推进，构建了涵盖二次侧液冷的全套产品矩阵。</p> <p>在商业模式上，公司与服务器厂商、云厂商及算力基础设施客户建立协同关系，可直接为其提供整体二次侧液冷系统方案，覆盖热仿真、结构设计、样机验证、系统集成到量产落地的全流程，能够形成长期、稳定、高粘性的客户绑定。</p> <p>在供应链体系上，公司逐步建立自主可控的关键零部件制造体系，覆盖微通道冷板、复合管路、快接头、金属结构件等核心环节，实现部件产能可控与显著的成本结构优势，并确保高可靠性和快速交付能力。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Q3、公司是否考虑通过并购等方式加速业务发展？**

公司秉承稳健的经营策略，专注于当前的核心主业，同时密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合市场动态及公司的发展需求，谨慎决策并适时考虑。

**Q4、公司半导体封装材料业务进展？**

公司半导体封装材料业务广泛涉及MOSFET、IGBT、SiC等IGBT功率模块的封装材料供应。2024 年相关产品收入占总营收比例近 10%，2025 年该业务增长势头仍然保持强劲。主要客户包括国内知名的功率半导体封装企业，目前，公司正积极向行业头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，以满足新能源汽车、光伏逆变器等领域的应用需求。

**Q5、公司的MLCP业务进展如何？公司的优势？**

答：公司MLCP产品目前已向重点客户交付样品，并将持续推进技术研发及产业化进程。MLCP技术是一种芯片级别的高效散热解决方案，公司长期积累的高导热金属封装材料技术、精密蚀刻及电镀复合工艺，与该技术路径高度契合。

**Q6、公司营收在 2022-2023 年波动的主要原因？未来业务发展的重点方向是什么？**

答：2022-2023 年的业绩波动主要是受国内外宏观经济下行的影响，公司主要产品细分领域的市场需求未达预期，该期间智能卡业务作为公司的传统核心业务，是公司收入与利润的主要来源，新拓展的业务尚处于早期投入阶段，相关产能及业绩未能释放。

展望今年，智能卡业务保持稳定，半导体封装材料业务也已形成了规模化的收入。公司新兴孵化的液冷散热业务板块正处于积极市场开拓阶段，虽然截至目前该板块的相关收入占公司营收比例较低，但公司产品具备结构创新和成本优势，随着客户认可度的提升及量产计划的推进，预计在核心客户的广泛应用下实现快速增长，并有望成为公司未来重要的收入来源。从长远来看，传统智能卡业务的收入规模预计

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>将维持相对稳定，随着公司其他主营产品业务增长而占比逐步下调。</p> <p><b>Q7、智能卡业务在海外市场的集中度和占比均较高，如何有效控制经营风险？关税战对公司的影响如何？</b></p> <p>答：智能卡行业的特点决定了客户集中度相对较高，通过签订长期的战略合作协议，公司与THALES、IDEMIA等全球知名智能卡系统公司保持长期友好合作关系。海外业务为公司核心战略支柱，收入占比长期超 60%，公司是智能卡行业内较早在海外设立生产基地的企业，凭借其前瞻性的海外生产基地产能布局和多年积累的成熟海外经营管理经验，在智能卡市场中建立了独特的竞争优势。</p> <p>近年来公司凭借丰富的大规模项目交付经验和服务能力，在国内积极争取与四大运营商长期合作，前五大客户收入占比从 2023 年的 87.92%降至 2024 年的 77.75%。此外，公司积极拓展多元客户群，延伸半导体封装、数字与能源热管理等新业务，有效地降低了对智能卡单一业务依赖。</p> <p>截至目前，公司没有直接向美国出口或采购的业务，关税战对公司影响相对较小。</p> <p><b>Q8、公司未来在研发投资方面的规划如何？特别在液冷技术和高端功率模块封装材料领域会有哪些布局？</b></p> <p>答：公司将技术创新视为核心竞争力，目前在智能卡、半导体等业务领域已积累了相对成熟的技术，部分研发项目阶段性完成，或正转向应用端的优化，公司长期坚持结合成本效益分析，确保对基础研发、核心技术的投入保持一定的比例。未来，研发投入将更加聚焦于半导体封装材料和新拓展的液冷散热业务。</p> <p>在液冷散热领域，研发的重点将集中在系统级测试平台的建设，以及二次侧体系的搭建与优化，涵盖MLCP、管路、CDU、直至机柜系统的集成。而在高端功率模块材料领域，近期研发的重点将投向厚铜引线框架及铜针底板。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Q9、半导体业务的客户和液冷业务的客户之间是否存在协同和渠道上的联系？**

答：目前，公司的半导体封装材料业务与液冷散热业务各自服务于不同的下游应用场景，客户群体整体上相对独立，销售渠道尚未出现直接重叠。半导体封装材料业务主要服务功率器件、汽车电子及新能源领域的相关客户，而液冷业务主要面向服务器整机厂、云服务提供商以及AIDC（人工智能数据中心）运营商。

尽管在客户结构上保持独立，但两条业务线在技术路径、工艺体系与未来发展趋势上高度协同。随着AI算力持续提升，液冷散热技术正从机柜级别向芯片封装级演进，其中代表性方向如 MLCP（微通道封装盖板）。此类新一代散热技术的开发需要芯片设计公司、芯片封装企业、服务器制造商和AIDC 运营商之间的深度协同开发，以实现从芯片封装、散热结构到整机部署的全链路优化。

因此在现阶段，两类业务的客户群体保持独立、销售渠道也各自分开。未来阶段，随着芯片级散热与先进封装技术的融合加速，两条业务线在技术、客户以及销售渠道方面存在协同合作和融合潜力。

**Q10、公司液冷产品在其他领域，如储能和新能源汽车的进展？**

答：从当前市场需求及毛利率的角度来看，公司现阶段的液冷散热业务更侧重于AI服务器领域的研发和应用。

**Q11、金属价格的波动是否对公司毛利产生了影响？公司是否已经采取了相应的措施来应对？**

答：公司生产所需的主要材料包括黄金、铜、银、锌等，金属价格的持续攀升会给公司带来原材料成本上升的挑战，进而对利润产生一定影响。公司一方面与关键客户保持密切沟通，建立能反映铜价波动的产品报价机制或铜价补差机制，以便共同承担成本波动的影响；另一方面，公司严格落实成本优化策略，致力于减少生产过程中的损耗、提高生产效率，通过多维度的措施来缓解金属价上涨的压力，并尽可能地减少其对利润的不利影响。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>Q12、苹果手机eSIM应用加速推广对公司业务的影响？</b></p> <p>近年来，随着工业互联网、AIoT、eSIM等新兴技术场景快速发展，为智能卡行业注入新的增长动能。eSIM业务的兴起有望提升公司产品的毛利率，推动公司 从制造端向服务端发展，助力公司智能卡业务实现价值提升。目前，公司的eSIM产品主要应用于工业物联网及消费电子等领域。公司长期与国际领先的智能卡系统企业、国内运营商保持紧密合作，掌握芯片封装、个性化处理、加密算法及安全认证等核心技术，具备eSIM相关的技术与商务基础。公司将密切关注 eSIM 市场的发展趋势和行业动态，依托技术的延续性、客户资源和产能保障，持续把握市场发展机遇。</p> |
| 风险提示         | <p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>                                                                                                                                                              |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日期           | 2025-11-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |